

Transfer Molding System

Model EZS1120



**Transfer molding system suitable for
small volume production of multiple products**

多品種少量生産に最適な トランスファモールド装置

製品情報



日本語

- ツールチェンジャによるKIT交換の簡易化や金型デザインの統一により、
金型・設備の品種交換性を向上
- コンパクト設計により容易な設備移動を実現
- 大型パッケージにも幅広く対応



SPECIFICATION

Items		Unit	Description
モデル		—	EZS1120
ワークタイプ		—	基板・リードフレーム
ワークサイズ	長さ	mm	150—300
	幅	mm	15—100
樹脂	径	mm	φ 13, 14, 16, 18, 20
	長さ	mm	14.3—35.0
マシンタイム		sec	Approximately 60
外形寸法	プレス数	module	1
	幅	mm	1,400
	奥行き	mm	1,380
	高さ	mm	1,880
重量		ton	3.5
成形取り数		workpiece	1
インプットマガジンスペース		mm	1 pce: 20—110(W) × 160—310(L) × 170(H)
アウトプットマガジン数（スタックマガジン仕様）		pcs	1
クランプ出力		kN/(tf)	196.0—1,176.0 / 20.0—120.0
トランスファ出力		kN/(tf)	3.9—98.0 / 0.4—10.0（2圧設定）
品種切替え方式		—	キット交換式
搭載可能金型		—	EZS1120専用金型

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105

京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.

台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.

韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

マレーシア
TOWA Malaysia Sales &
Services Sdn. Bhd.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ